

PCT

世界知的所有権機関
国際事務局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H01L 21/304, 21/308, C23F 1/16		A1	(11) 国際公開番号 WO00/13217
			(43) 国際公開日 2000年3月9日(09.03.00)
(21) 国際出願番号 PCT/JP99/04694			松沢 純(MATSUZAWA, Jun)[JP/JP]
(22) 国際出願日 1999年8月31日(31.08.99)			〒317-8555 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki, (JP)
(30) 優先権データ 特願平10/245616 特願平10/351188	1998年8月31日(31.08.98) 1998年12月10日(10.12.98)	JP JP	本間嘉夫(HONMA, Yoshio)[JP/JP] 近藤誠一(KONDOW, Seiichi)[JP/JP] 〒185-0014 京都府国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社 日立製作所 中央研究所内 Tokyo, (JP)
(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.)(JP/JP) 〒163-0449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo, (JP)			(74) 代理人 弁理士 宮田和子, 外(TOMITA, Kazuko et al.) 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目9-10 横浜HSビル7階 Kanagawa, (JP)
(72) 発明者: および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 内田 剛(UCHIDA, Takeshi)[JP/JP] 星野 鉄哉(HOSHINO, Tetsuya)[JP/JP] 上方 康雄(KAMIGATA, Yasuo)[JP/JP] 寺崎 裕樹(TERAZAKI, Hiroki)[JP/JP] 〒305-4247 茨城県つくば市和台48番 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki, (JP)			(81) 指定国 AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), 一ラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
			添付公開書類 国際録在報告書

(54) Title: ABRASIVE LIQUID FOR METAL AND METHOD FOR POLISHING

(54) 発明の名称 金属用研磨液及び研磨方法

(57) Abstract

An abrasive liquid for a metal comprising (1) an oxidizing agent for a metal, (2) a dissolving agent for an oxidized metal, (3) a first protecting film-forming agent such as an amino acid or an azole which adsorbs physically on the surface of the metal and/or forms a chemical bond, to thereby form a protecting film, (4) a second protecting film-forming agent such as polysacrylic acid, polyamido acid or a salt thereof which assists the first protecting film-forming agent in forming a protecting film and (5) water; and a method for polishing.